共达电声股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

为了持续加强共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体竞争实力，公司于2026年8月14日召开了第六届董事会第二十二次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）共同对合肥硅臻芯片技术有限公司（以下简称“硅臻芯片”）进行投资，并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增资协议》《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》。在本次投资完成后，公司将合计持有硅臻芯片1.7813%的股权。具体详见《共达电声股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

二、对外投资进展情况

截至本公告日，公司已将相应的人民币2,000万元投资款实缴到位，硅臻芯片已经完成本次投资事项相关的工商变更及备案事项。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日